

2022年8月30日

報道関係各位

PALTEK SOLUTION SUPPLIER
PALTEK
プレスリリース
株式会社 PALTEK

**PALTEK「国際物流総合展 2022 Logis-Tech Tokyo 2022」に出展
9月13日(火)から9月16日(金)まで東京ビッグサイトで開催
～紙が物流コストと環境問題を変えていく～**

株式会社 PALTEK（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：福田 光治、以下 PALTEK）は、2022年9月13日（火）から9月16日（金）まで、東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催される「国際物流総合展 2022 Logis-Tech Tokyo 2022」に出展し、「紙が物流コストと環境問題を変えていく」をテーマに、Ranpak 株式会社（以下 Ranpak）の紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進について提案します。

新型コロナウイルスの感染拡大に影響により、EC・物流業界は大きく様変わりしました。巣ごもり需要の増加などによりネットショッピングの利用が拡大し、物流量は大幅に増加するなかで、EC 事業者や物流事業者では出荷作業のオートメーション化などの物流生産性向上が求められています。また、世界的な「脱プラスチック」の流れは加速しており、プラスチック系の梱包資材の使用を控える動きなども顕著になっています。



展示会出展ブースイメージ

PALTEK の提供する Ranpak の紙梱包資材はプラスチック製品の梱包資材の置き換えが可能のため、食品や雑貨・日用品を扱う通信販売や実店舗での採用に加え、電子機器などの精密機器や医薬品など、さまざまな商品の緩衝材として採用が広がっています。Ranpak の紙梱包資材は、独自の技術により高い緩衝能力を発揮し、梱包方法の最適化により梱包資材コストの低減、資材保管スペースの縮小、梱包作業の高速化による労働コストの削減などのトータルコストの大幅な削減が可能となります。

「国際物流総合展 2022 Logis-Tech Tokyo 2022」は、国内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に結集し、交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的とした展示会です。

PALTEK ブースでは、2020年6月に日本国内で販売を開始した次世代緩衝材システム「PadPak®Guardian」の実演やラッピングシステムなどを展示し、Ranpakの紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進を提案します。お客様のコスト全体に影響を及ぼす要素の改善を提案や、シンプルかつ小型で小売店の少量ラッピング用途に最適な店内用の梱包ソリューション「Geami Wrap 'n Go™」についても展示します。

■ 展示会の概要

展示会名	: 「国際物流総合展2022 Logis-Tech Tokyo 2022」
開催日時	: 2022年9月13日(火)から9月16日(金) 10:00～17:00
会場	: 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東1～8ホール PALTEKブースは、3-207
主催	: 一般社団法人 日本産業機械工業会
展示会URL	: https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/ltt/index.html
来場事前	: https://www.logistech-online.com/jp/registration.php
登録URL	: (ご来場の際には招待券または事前登録が必要となります。)

■ 主な出展内容

・次世代緩衝材システム:PadPak®Guardian

「PadPak®Guardian」は、梱包速度の向上によるコスト削減に加え、C字型に折り畳まれたペーパーを採用したことにより、緩衝材の補充作業など使い勝手のよい操作性を提供します。

これにより、電子・電気部品から自動車用スペアパーツや産業機械設備などの重量のある商品まで、幅広い商品の梱包ニーズに応えます。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/padpak/padpak_guardian/index.html

・高速すき間埋めシステム:FillPak®

「FillPak®」は、配送箱と製品とのすき間を高速に埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/fillpak/index.html>



次世代緩衝材システム
「PadPak®Guardian」



高速すき間埋めシステム「FillPak®」

・ラッピングシステム:Geami WrapPak®

「Geami WrapPak®」は、特許を取得したダイカット（切り込み）入りクラフト紙と台紙の組み合わせで商品を守り、迅速な梱包と美しい見た目を両立します。



ラッピングシステム「Geami WrapPak®」

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/geami_wrappak/index.html

・Geami Wrap 'n Go™

Geami Wrap 'n Go™は、小売店内での少量ラッピング用途に最適です。あらゆる梱包環境に追加で統合いただけるほか、特許取得済みのテンション自動調整機能により、簡単な操作で保護資材への展開が可能です。Geami Wrap 'n Go™は、サステナブルな紙素材を使用しており、気泡緩衝材に比べ環境への負荷を大きく低減します。また、高い保護能力を提供するとともに、より楽しい開梱体験をお約束します。



Geami Wrap 'n Go™

詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.ranpak.com/jp/products/geami-wrap-n-go/>

■ Ranpak株式会社について

Ranpakは世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する紙梱包資材を提供することを目標に1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上にわたる経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で6万社のユーザーに提供しております。Ranpak BVは、欧州およびアジアに100以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリスなど）の成熟市場、東ヨーロッパ（ポーランド、スロバキア、トルコ）の発展途上市場、およびアジア太平洋（オーストラリア、日本、シンガポールなど）など、世界中に拠点があります。

Ranpakに関する詳細は、<https://www.ranpak.com> をご覧ください。

■ 株式会社PALTEKについて

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。なお、2021年6月よりPALTEKは株式会社レスターホールディングスのグループ企業となりました。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：ニュースリリースに関するお問い合わせ

会社名	株式会社 PALTEK
担当者	広報担当 柴崎、寺田
メールアドレス	pr@paltek.co.jp
所在地	〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F
電話	045-477-2072

2：本展示会に関するお問い合わせ

会社名	株式会社 PALTEK
担当者	「国際物流総合展 2022 Logis-Tech Tokyo 2022」展示会担当者
メールアドレス	eg_solution2@paltek.co.jp
所在地	〒140-0001 東京都品川区北品川 2-32-3 六行会総合ビル 7 階
電話	03-4241-2597